**著作权转让协议办理通知**

按照我刊主管部门的要求，为了保护知识产权，凡向我刊所投稿件，作者需签署《论文著作权转让协议》，将该论文的著作财产权在全球范围内转让给我刊。《论文著作权转让协议》见附件。

著作权转让协议以扫描或拍照的方式通过投稿系统网站上传或发送至编辑部邮箱。

编辑部电话：0311-87091339

E-mail：[bdtj1339@vip.163.com](mailto:bdtj1339@vip.163.com)

网站：www.bdtj.cbpt.cnki.net

《半导体技术》编辑部

**论文著作权转让协议**

论文题目：

作者（依序排列）：

投稿期刊： 《半导体技术》

以上论文的全体作者（著作权人）同意将上述论文在《半导体技术》期刊发表，自愿将该论文的著作财产权在全球范围内转让给《半导体技术》编辑部，并就有关问题明确如下：

1. 论文全体作者保证该论文为原创作品并且不涉及涉密和一稿多投等各种学术不端问题，若发生侵权或泄密问题，一切责任由论文作者承担。

2. 论文全体作者同意上述提交《半导体技术》期刊发表的论文一经录用，作者即将论文整体以及附属于作品的图、表、公式、摘要及增强出版内容（如论文研究问题、研究思想、方法、过程、数据、结果的详细资料，包括理论推导和实验过程等内容）或其他可以从论文中提取部分的全部复制传播的权利——包括但不限于复制权、发行权、信息网络传播权、表演权、翻译权、汇编权、改编权等著作财产权转让给《半导体技术》编辑部。

3. 本刊已许可中国知网、万方、维普、超星、电子信息领域期刊集群、美国《化学文摘》（CA）、美国《剑桥科学文摘》（CSA）、美国《乌利希期刊指南》(UPD)、英国INSPEC、俄罗斯《文摘杂志》（AJ of VINITI)、日本科学技术振兴机构数据库（JST）、美国《史蒂芬斯数据库》（EBSCOhost）等数据库以数字化方式复制、汇编、信息网络传播本刊全文及摘要。所有著作权转让费用均包含在论文刊登后《半导体技术》期刊支付的稿酬中，不再另行支付费用。

4. 论文全体作者保证该论文的署名无争议。若发生署名争议，责任由论文作者承担。

**5. 本协议需全体作者亲笔签字，自签字之日起生效。协议签署后需将协议扫描件/照片发送至编辑部邮箱或通过投稿系统上传，视为认可协议扫描件/照片与原件具有同等法律效力。若所投论文最终未被录用发表，则本协议自动失效。**

全体作者签名（作者一般为7个以下）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 作者姓名  （亲笔签字、依序排列） | 作 者 单 位 | 签署日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |